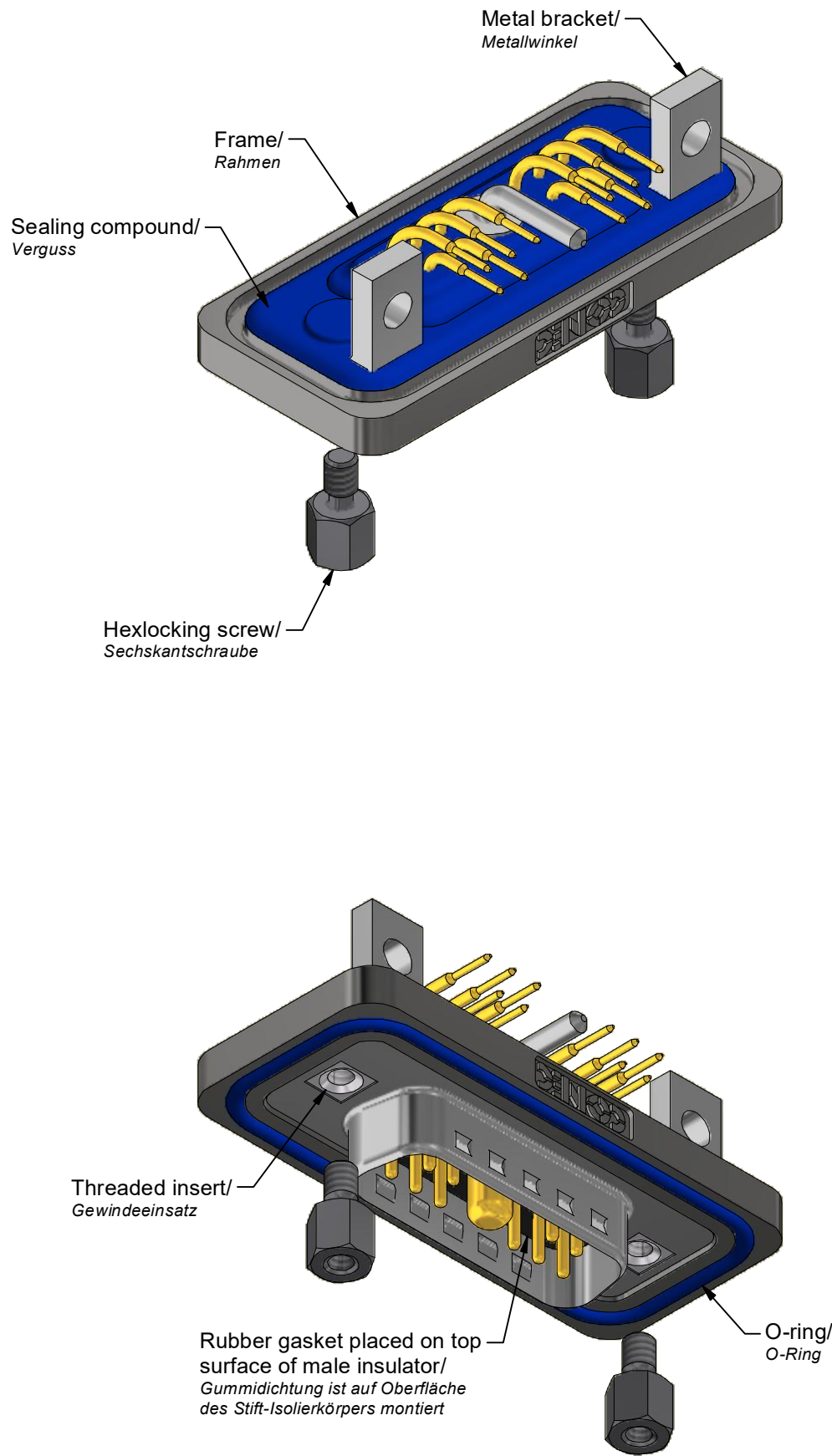


At all times water resistant connectors not in use should be covered with a Conec water resistant cap or water tight hood.  
 Im nicht gesteckten Zustand müssen die wasserdichten Steckverbinder mit einer wasserdichten Conec Kappe oder Haube geschützt werden.



**Technical specification/**

**Technische Daten:**

Dielectric withstanding voltage/ Spannungsfestigkeit:	1000 V, 50 Hz 1 min.
Current rating/ Strombelastbarkeit:	Signal contact/ 7,5 A (UL) Signalkontakt: 5,0 A (CSA) High power contact/ 15 A Hochstromkontakt:
Insulation resistance/ Isolationswiderstand:	≥ 5 GΩ
Degree of protection/ Schutzart: IEC 60529	IP67, in mated condition/ IP67, im gesteckten Zustand
Temperature range/ Temperaturbereich:	- 25 °C ... + 105 °C
Mating cycles/ Steckzyklen:	Quality class 3 = 50 Gütestufe 3

**Materials/**

**Werkstoffe:**

Signal contact/ Signalkontakt:	Cu alloy, Au over Ni
High power contact/ Hochstromkontakt:	Cu alloy, mating area/Steckbereich: Au over Ni termination side/Anschluss Seite: Sn over Ni
Insulator/ Isolierkörper:	PBT GF UL 94 V-0, green/grün
Shell/ Gehäuse:	Cu alloy, Sn over Ni
Metal bracket/ Metallwinkel:	GD-Zn, Sn over Ni
Frame/ Rahmen:	GD-Zn, Ni
Threaded insert/ Gewindeeinsatz:	Cu alloy, Sn over Ni
Collar/ Scheibe:	Cu alloy, Sn over Ni
O-ring/ O-Ring:	Silicone/ Silikon
Sealing compound/ Verguss:	PUR
Rubber gasket/ Gummidichtung:	TPE
Hexlocking screw/ Sechskantschraube:	Stainless steel/ Edelstahl

**Installation specification/**

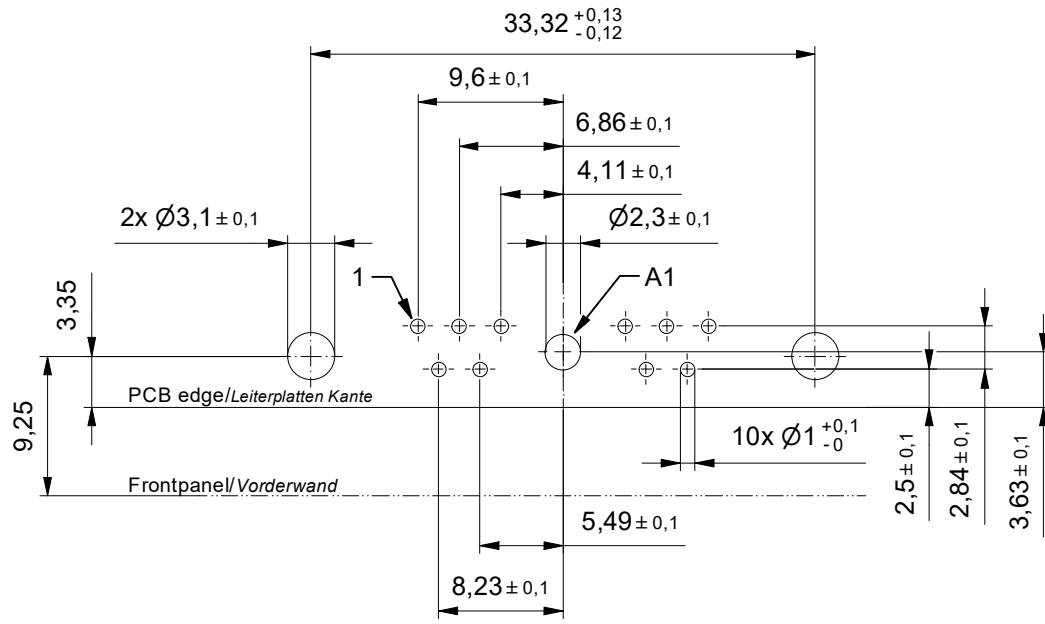
**Montagedaten:**

Solder parameter for wavesoldering/ Lötparameter im Wellenlötverfahren:	
Solder preheat temperature/ Vorheiztemperatur:	120 °C for 120 sec. max./ 120 °C für 120 Sek. max.
Solder bath temperature/ Lötbadtemperatur:	240 °C for 5 sec. max./ 240 °C für 5 Sek. max.
Recommended torque value for thread/ Empfohlenes Drehmoment für Gewinde:	3.1 in.LB / max. 3.5 in.LB/ 35 Ncm / max. 40 Ncm
PCB hole drillings/ Recommended panel cut-out/ Leiterplattenbohrbild/ Empfohlener Montageausschnitt:	see sheet 2/ siehe Seite 2
Rear panel thickness/ Rückwandstärke:	1,0 mm min. ... 1,6 mm max.

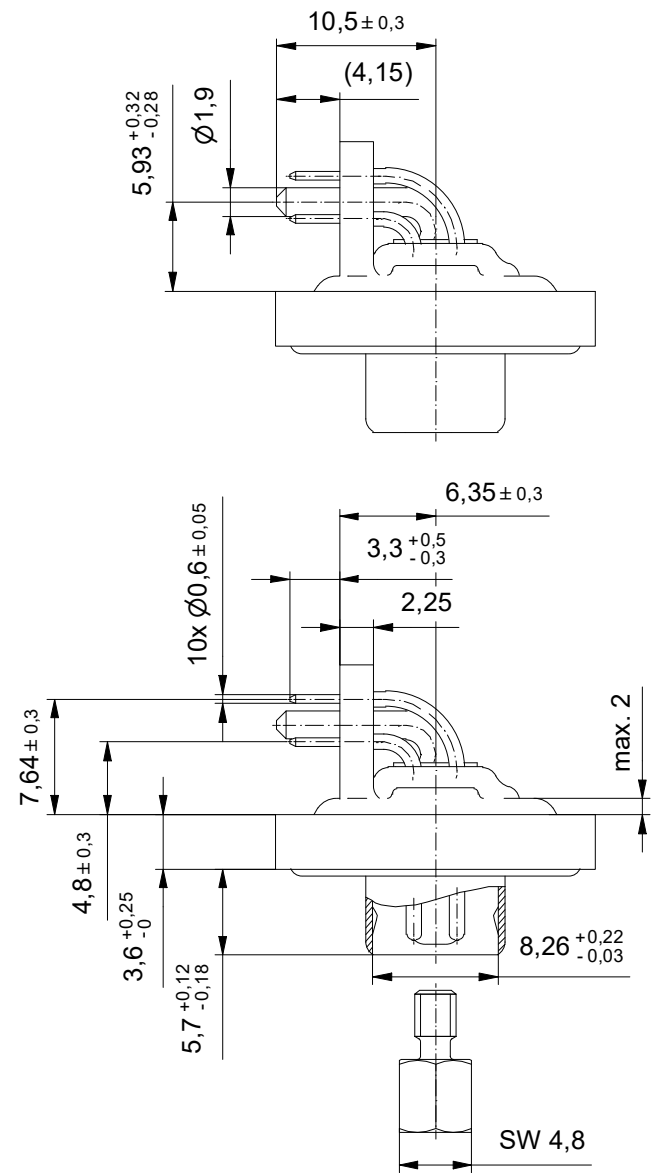
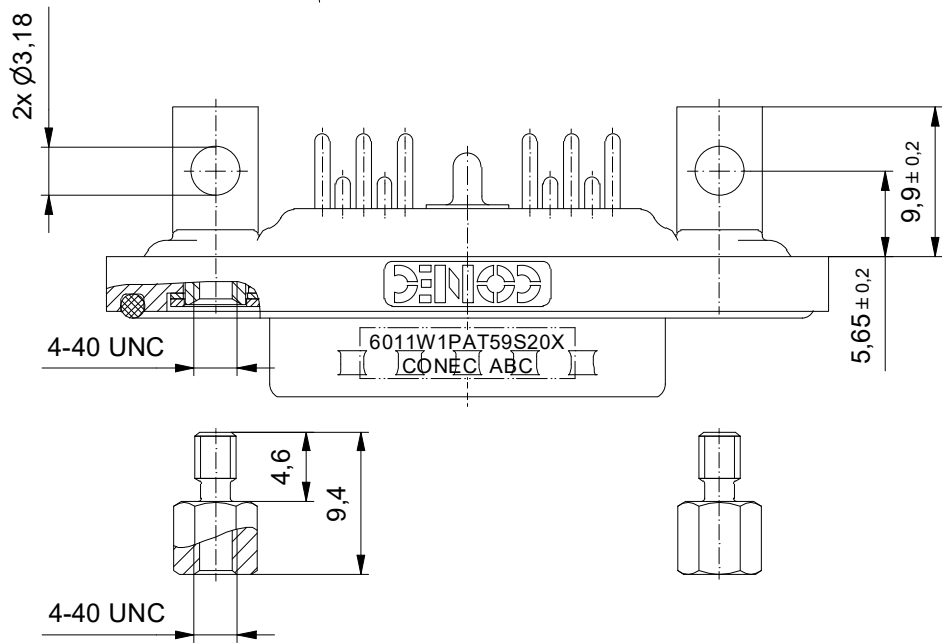
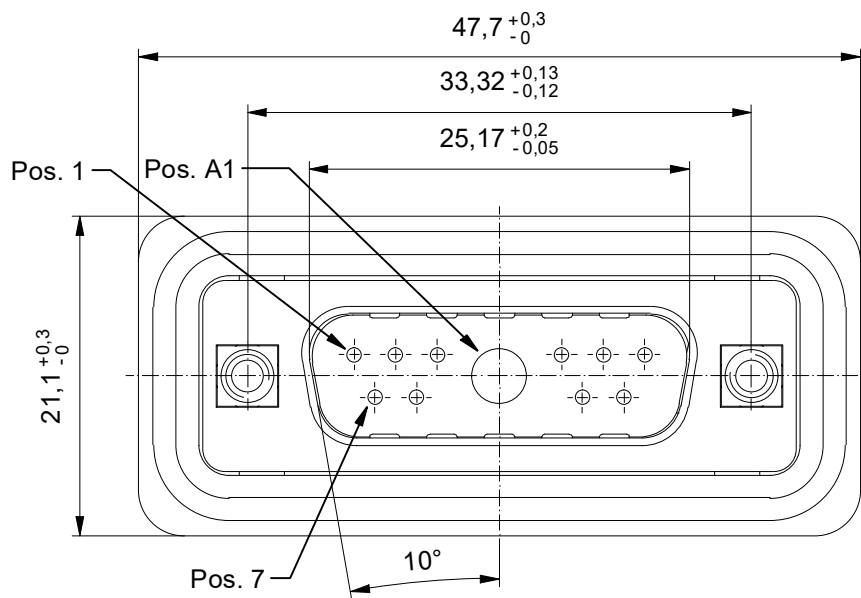
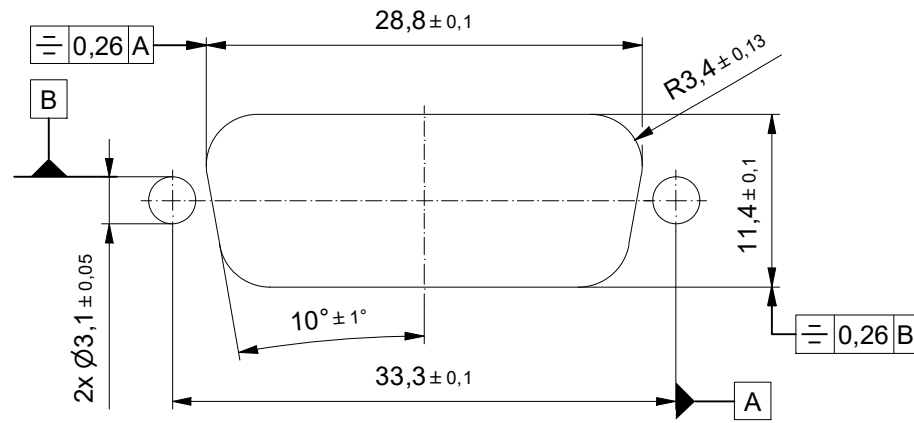
Part no. / Part marked/ Art.-Nr. / Bedruckung:	6011W1PAT59S20X	Contact plating/ Kontakt Veredelung:	Signal contact/ Signalkontakt:	gold flash over nickel Gold über Nickel
		High power contact 15 A/ Hochstromkontakt 15 A:	plating, mating area/ Veredelung, Steckbereich:	gold flash over nickel Gold über Nickel
			plating, termination side/ Veredelung, Anschluss Seite:	tin over nickel Zinn über Nickel
			dim. in mm	D-SUB COMBINATION MALE 90° 11W1P with threaded insert, metal bracket and hexlocking screw D-SUB COMBINATION STIFT 90° 11W1P mit Gewindeeinsatz, Metallwinkel und Sechskantschraube
			Date/Datum	Name
			drawn/ gez.	09.02.2026 JLE
			appd./ gepr.	09.02.2026 ABU
Index: a	scale/Maßstab:	2:1	<b>Amphenol</b> <b>CONEC</b>	dwg no / Z.-nr.: 15K1A2501
				DIN-A3 1 / 2

The reproduction, distribution and utilization of this document is allowed in full or in part for the purposes of design. All rights reserved in the event of the grant of a patent, utility model or design. We reserve the right to change the design without notice. We are not liable for damages. Wir behalten uns das Recht vor, Änderungen ohne Vorwarnung vorzunehmen. Wir übernehmen keine Haftung für Schäden.

PCB hole drillings  
(PCB top side)  
Leiterplattenbohrbild  
(Leiterplatten Oberseite)



Recommended  
panel cut-out/  
Empfohlener  
Montageausschnitt:



Index: a	scale/Maßstab: 2:1	dim. in mm	D-SUB COMBINATION MALE 90° 11W1P with threaded insert, metal bracket and hexlocking screw		dwg no / Z.-nr.: 15K1A2501	DIN- A3									
			<table border="1"> <tr> <td>Date/Datum</td> <td>Name</td> </tr> <tr> <td>09.02.2026</td> <td>JLE</td> </tr> <tr> <td>appd./ gepr.</td> <td>ABU</td> </tr> <tr> <td>09.02.2026</td> <td></td> </tr> </table>	Date/Datum			Name	09.02.2026	JLE	appd./ gepr.	ABU	09.02.2026		D-SUB COMBINATION STIFT 90° 11W1P mit Gewindeeinsatz, Metallwinkel und Sechskantschraube	
			Date/Datum	Name											
09.02.2026	JLE														
appd./ gepr.	ABU														
09.02.2026															